

入場無料

令和6年度

山梨大学半導体セミナー

2024.11.29(金) 9:00 ▶ 12:00

山梨大学大村智記念学術館大村記念ホール

山梨大学甲府キャンパス内 【受付は8:30~】

現地参加とオンライン参加のハイブリッドで開催します

- 9:00~9:10 (10分) 開会の辞
山梨大学 理事 (産学官連携担当) 市川 満
- 9:10~9:30 (20分) イントロダクトリートーク
山梨大学 教授 矢野 浩司
- 1 9:30~10:10 (40分)
AIインフラを支える光・無線通信デバイスの現状と未来
住友電工デバイス・イノベーション株式会社
東 敏生 氏
- 2 10:20~11:00 (40分)
車載用パワー半導体の現状と将来展望
株式会社豊田中央研究所
山下 侑佑 氏【オンライン】
- 3 11:10~11:50 (40分)
空調機におけるパワー半導体適用技術と動向
日本キャリア株式会社
遠藤 隆久 氏
- 11:50~12:00 (10分) 閉会の辞
山梨大学 理事 (学術研究担当) 茅 暁陽

【事前申し込みはこちらから】
<https://forms.office.com/r/yEQMUW8yqP>

※参加申し込み期限 11月22日 (金)



定員

- 現地 : 130名
- オンライン : 200名

【主催】

山梨大学研究推進・社会連携機構、山梨大学工学部工学科電気電子工学コース、電気学会東京支部
山梨支所

【お問い合わせ先】

山梨大学社会連携課 藤巻・矢野 TEL : 055-220-8760
E-mail : shakaire@yamanashi.ac.jp

■開催の趣旨

半導体は情報通信端末、家電、自動車、電鉄、産業機器など様々な機器に搭載されており、我々の生活に無くてはならないものになっています。今や世界の半導体市場は5000億ドルを超えるとされており、将来は、DXやGXの推進、AIの普及に伴い、益々その需要が高まると予測されます。

一方で、日本は少子化に伴い半導体に携わる人材不足の問題が顕在化しています。本学では、こうした背景を踏まえ将来の半導体製造を担う優秀な人材を育成すること、半導体に関連する人的交流を図ることを本セミナーの目的とし、今回は、情報通信、自動車、家電の各分野から講師をお招きし、関連する半導体技術および将来展望について講演していただきます。皆様のご参加をお待ちしています。

■会場案内

